

پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر

نقش دمای خشک کردن و فشار مکانیکی بر ساختار سطحی و خواص دینامیکی فیلم نانوساختار پلی آنیلین

علیرضا بهرامیان*

همدان، گروه مهندسی شیمی، دانشیار دانشگاه صنعتی همدان

فصلنامه علمی - پژوهشی بین‌رشته‌ای

سال دوم، شماره ۲، نسخه ۱،

تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۳-۱۶

چکیده

در این پژوهش نقش دمای خشک کردن و فشار مکانیکی بر ساختار سطحی و خواص دینامیکی فیلم نانوساختار پلی-آنیلین (PAni) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا PAni طی فرایند پلیمری شدن آنیلین در حضور آمونیوم پرسولفات در محیط اسیدی سنتز و در حلال نرم ال متیل-۲-پیروولیدین حل شد. محلول به دست آمده به روش لایه‌نشانی غوطه‌وری به صورت فیلم نانوساختار روی زیولایه شیشه‌ای از جنس کوارتز لایه‌نشانی و خشک شد. نتایج تحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد با افزایش دمای خشک کردن، ساختار سطحی فیلم از حالت لیفی به شبکه‌ای متقاطع به هم پیوسته در می‌آید. تصاویر میکروسکوپ عبوری نشان دادند قطر ساختارهای لیفی شکل در دمای ۳۱۸ و K ۴۱۸ به ترتیب ۱۸ و ۳۰ نانومتر است. تحلیل نیروی اتمی نشان داد میزان متوسط زیری سطحی فیلم PAni در دمای ۳۱۸ K بدون اعمال فشار مکانیکی ۶۳ نانومتر و در فشار ۵ مگاپاسکال به کمتر از ۳۵ نانومتر می‌رسد. آزمایش‌های تحلیل دینامیکی-مکانیکی-حرارتی نشان دادند دمای انتقال شیشه‌ای فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و فیلم تهیه شده در فشار ۵ مگاپاسکال به ترتیب برابر ۲۸۶ و K ۳۷۸ است. آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی به روش دندانه‌گذاری در مقیاس نانومتری با هدف تعیین مقادی سختی، مدول کشسانی و ضریب پوآسون فیلم PAni به کار گرفته شد. بررسی وابستگی دمایی و فشار اعمال شده روی سطح فیلم در تعیین خواص گرانزوکشسان فیلم PAni می‌تواند اطلاعات مناسبی را درخصوص میزان مدول ذخیره و مدول اتصال فیلم و انرژی فعالسازی لایه پلیمری طی فرایند تجزیه گرمایی در اختیارخواننده قرار دهد.

واژه‌های کلیدی

پلی آنیلین
فیلم نانوساختار
اثرات دما و فشار
خواص گرمایی
خواص مکانیکی-دینامیکی

* مسئول مکاتبات:

bahramian@hut.ac.ir

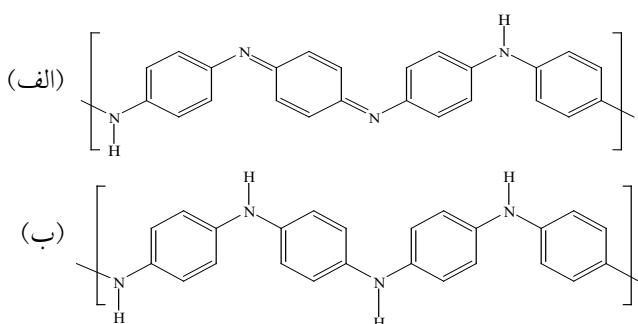
مقدمه

را تحت تأثیر قرار دهد [۸]. سنتز شیمیایی PAni توسط واکنش اکسایش آنیلین یا نمک‌های آن نظیر آنیلینیوم کلرید و آنیلینیوم فلورید در محیط اسیدی اتفاق می‌افتد. در فرایند اکسایش به طور معمول از اکستنده قوی نظیر آمونیوم پراکسی دی سولفات استفاده می‌شود [۹-۱۲]. اغلب، حللاهای شیمیایی نظیر متا-کرزول، کلروفرم، دی‌متیل سولفوكساید و نرمال-متیل-۲-پیرولیدین (NMP) برای انحلال PAni پودر به کار می‌روند [۱۰]. هرچند استفاده از NMP به دلیل انحلال پذیری خوب آن با Pani به طور معمول بیشتر مورد توجه قرار گرفته است [۱۲]. مطابق شکل ۱ PAni دارای دوساختار شیمیایی امرالدین (PAni-EB) و لئوکو امرالدین (PAni-LEB) است که به یکدیگر تبدیل می‌شوند. فرم EB به عنوان گونه نیمه رسانا طی واکنش کاهشی به گونه نارسانای LEB تبدیل می‌شود.

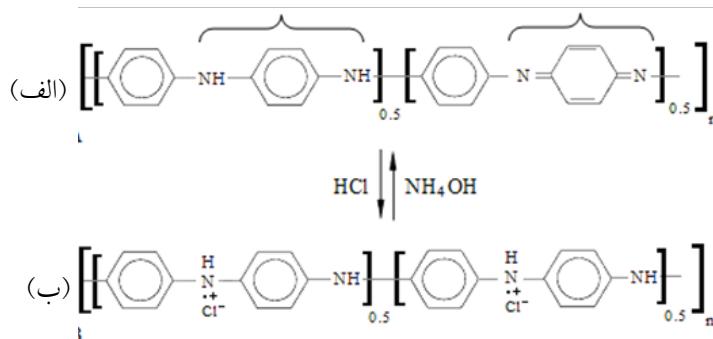
مطابق شکل ۲ ساختار شیمیایی PAni از دو گونه PAni بنزوئید و کوینوئیدی آمین تشکیل شده است. در حضور اسید کلریدریک از ساختار نیمه رسانای EB (شکل ۲ الف) به صورت نمک رسانای ES (شکل ۲ ب) درمی‌آید. خلاف واکنش اخیر در حضور عامل قلیایی (آمونیوم هیدروکسید) رخ می‌دهد (شکل ۲). همان‌طور که از شکل ۲ ب می‌توان دریافت ساختار نمک ES حاصل به طور ذاتی از یک گونه کاتیون رادیکال $[C_6H_4NH]^{2+}$ -Cl⁻ تشکیل شده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که عملیات گرمایی می‌تواند تأثیربیزایی بر ساختار سطحی و خواص دینامیکی فیلم‌های پلیمری بگذارد [۱۳-۱۴]. تحلیل رویش

در سال‌های اخیر استفاده از فیلم‌های رسانای پلیمری کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف نظیر نوری و میکروالکترونیک، ذخیره‌سازهای انرژی، پزشکی، غشاء‌های جداکننده گاز و حسگرهای شیمیایی پیدا کرده‌اند [۱-۳]. علاقه به استفاده از فیلم‌های پلیمری وقتی شکل جدی‌تری به خود گرفت که پژوهشگران دریافتند خواص فیزیکی فیلم‌های نازک در سطح و درون توده پلیمر متفاوت است و همچنین با کاهش ضخامت فیلم پلیمری خواص آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد [۴]. استفاده از نانوفناوری این امکان را فراهم می‌سازد تا توجهات به سمت ساخت فیلم‌های نازک نانوساختار با خواص سطحی ویژه افزایش یابد. همین موضوع سبب شده انقلاب عظیمی در ساخت و مشخصه یابی فیلم‌های نانوساختار در سامانه‌های نانوالکترونیک و نانوحسگرها به وجود آید. در میان پلیمرهای رسانای معروف نظیر پلی‌تیوفن، پلی‌پیرول، پلی‌پارافنیلن و مشتقان آن‌ها، پلی آنیلین (PAni) به دلیل رسانای مناسب و امکان سنتز آسان آن نسبت به بقیه مواد بیشتر مورد توجه محققان حوزه الکترونیک و نور قرار گرفته است. بررسی خواص مکانیکی-دینامیکی و گرانزوکشسان فیلم‌های نازک پلیمری به دلیل تأثیر ضخامت فیلم بر رسانایی و استحکام مکانیکی فیلم نهایی از اهمیت بالایی در حوزه‌های کاری یاد شده برخوردار است [۵-۷]. همچنین ساختار سطحی فیلم تهیه شده می‌تواند به شدت خواص گرانزوکشسانو رسانش الکتریکی فیلم



شکل ۱ ساختارهای امرالدین (الف) و لئوکو امرالدین (ب) مولکول پلی آنیلین



شکل ۲ ساختار پلی آنیلین در حضور اسید کلریدریک و آمونیوم هیدروکسید. (الف) فرم امرالدین و (ب) نمک امرالدین

حرارتی می تواند به عنوان راه حلی مناسب برای تعیین T_g فیلم پلیمری در تشخیص انتقال از حالت شیشه‌ای به لاستیکی طی عملیات گرمادهی و پخت مورد استفاده قرار گیرد. خواص مکانیکی فیلم نانوساختار شامل مدول کشسانی یانگ و ضریب پوآسون را می توان به روش میکروسکوپ نیروی اتمی به "روش دندانه گذاری در مقیاس نانومتری" در دماهای مختلف و فشار مکانیکی اعمال شده روی سطح فیلم اندازه گیریکرد [۱۸]. این روش برپایه مقدار مساحت عمل سوزن نفوذگر روی سطح فیلم عمل می کند. سوزن نفوذگر در روش دندانه گذاری فیلم نازک PAni لازم است تا شرایط عملیاتی نظیر در مقیاس نانومتریمی تواند باشکلهای هندسی کروی، مخروطی، هرمی سه ضلعی هرمی چهار ضلعی طراحی و ساخته شود. در مورد تحلیل فیلم های نانوساختار پلیمری، استفاده از سوزن های نوک تیز به دلیل امکان تغییر شکل پلاستیکی فیلم، گزینه مناسبی نسبت به سوزن های کروی شکل است. اندازه گیری خواص کشسانی و سختی فیلم معمولاً توسط سوزن "برکوویچ" با ساختار هرمی سه ضلعی صورت می گیرد. هرچند انتخاب نوع سوزن به نوع زیر لایه، ضخامت فیلم و میزان خاصیت کشسانی فیلم وابسته است [۱۹].

در این تحقیق خواص گرمایی-مکانیکی و همچنین خواص گرانزوکشسان فیلم نانوساختار PAni لایه نشانی شده روی سطح لام شیشه‌ای به عنوان زیرلایه مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار سطحی فیلم های پلیمری تهیه شده در دماهای خشک کردن مختلف طی اعمال

کالری سنجی و آزمون خواص دینامیکی-مکانیکی-حرارتی نشان دادند که ساختار فیلم PAni گرمادهی شده در دماهای بالاتر از ۴۰۰ K منجر به تشکیل فیلم با ساختار سطحی شبکه‌ای متقطع می شود [۱۵]. MacDiarmid و همکارانش نشان دادند ارتباط بین نیتروژن های گروه عاملی ایمین و حلقه های کوئینوئید در زنجیر PAni منجر به تشکیل ساختار دو بعدی و شبکه‌ای فنازین می شود [۱۰ و ۱۱]. Lee و همکارانش نشان دادند که واکنش شبکه‌ای شدن زنجیره های PAni در دماهای ۴۲۰ طی دو ساعت رخ می دهد [۱۶]. به منظور کاربری ابزاری فیلم نازک PAni لازم است تا شرایط عملیاتی نظیر دمای خشک کردن فیلم به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد. دمای انتقال شیشه‌ای (T_g) یکی از عوامل مهمی است که متأثر از شرایط ساخت فیلم پلیمری است. همچنین T_g فیلم در سطح پلیمر و ساختارهای درون لایه ای آن بسته به نوع برهم کنش های بین زنجیره های مولکول متفاوت است. وجود برهم کنش های ناخواسته بین زنجیره فیلم پلیمری و زیر لایه بر مقدار T_g فیلم حاصل موثر است [۱۷ و ۱۸]. در سال های اخیر روش های آزمایشگاهی متنوعی نظیر طیف سنجی جرمی یون ثانویه، طیف سنجی بازتاب پرتو ایکس و طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون برای بررسی تأثیر دمای خشک کردن بر خواص مکانیکی-دینامیکی-حرارتی فیلم های نانوساختار پلیمری به کار گرفته شده اند که اغلب پرهزینه و پیچیده هستند. آزمون مکانیکی-دینامیکی-

۳۰ دقیقه گرمادهی شدند. سپس فیلم‌های حاصل در دمای محیط سرد شدند. به منظور بررسی اثرات فشار مکانیکی اعمال شده بر سطح فیلم، هر یک از فیلم‌های تهیه شده بین دو صفحه موازی فلزی با جداره داخلی از جنس تفلون قرار گرفتند. فشار لازم در محدوده ۰/۵ تا MPa ۵ از طریق جک هیدرولیکی طی ۵ دقیقه در دمای ثابت به نمونه وارد آمده و نمونه‌های حاصل آمده تحلیل شدند.

۴-۲ دستگاه‌ها و تحلیل نمونه‌ها

ضخامت فیلم‌های PAni از طریق ارتفاع سنج نوری مدل ZeScope اندازه گیری شد. ساختار سطحی فیلم‌های حاصل به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل SEM,Cam Scan MV 2300 عبوری مدل Zeiss EM900TEM تعیین شد. به منظور آماده سازی نمونه‌ها جهت تصویربرداری لازم است تا ابتدا پس از برش قسمت مشخصی از فیلم PAni برش خورده و سپس بر اساس وضعیت نمونه‌ها، سمباده زنی و پولیش کاری سطحی صورت گیرد. پس از تمییز کاری نمونه‌ها و خشک کردن، سطح فیلم‌ها توسط لایه نازکی از طلا پوشش دهی شدند تا آماده تصویربرداری شوند. به کمک دستگاه تحلیل دینامیکی-مکانیکی-حرارتی مدل RSA IIIDMTA، TA Instruments فیلم در دماهای مختلف تحت گرمادهی به کمک گاز نیتروژن تعیین شد. این دستگاه امکان تغییر دما با نرخ رشد $2\text{ K}/\text{min}$ را در فرکانس یک هرتز تحت ولتاژ جریان متناوب فراهم می‌سازد. ویژگی گرانزوکشسان فیلم نظر مدول کشسانی یانگ، ضربی پوآسون، مدول ذخیره و مدول اتلاف فیلم به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی مدل DME, DS-95-50AFM شد. سرعت پایش و ثابت نیروی وارد شده روی سطح فیلم به ترتیب $0/2\text{ m}/\mu\text{s}$ و $42\text{ N}/\text{m}$ انتخاب شد.^[۱۹] روش مورد استفاده دندانه‌گذاری در مقیاس نانومتری بوده که از سوزن "برکوویچ" با ساختار هرمی سه ضلعی انجام شد. آزمایش‌ها به روش اندازه گیری میزان نیروی وارد شده در واحد سطح مورد بررسی انجام و خطای آزمایش‌ها از پردازش داده‌های به دست آمده

فشار مکانیکی روی سطح فیلم به کمک میکروسکوپ پراش الکترونی و میکروسکوپ عبور الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. به کمک آزمون دینامیکی-مکانیکی-حرارتی خواص گرمایی فیلم، دمای انتقال شیشه ایفیلم در دماهای مختلف خشک کردن مورد بررسی قرار گرفت. خواص مکانیکی شامل سختی، مدول یانگ و ضربی پوآسون فیلم‌های تهیه شده در دما و تحت فشارهای مکانیکی مختلف تعیین شد. همچنین بررسی اثر دمایی روی خواص گرانزوکشسان یافیلم نانوساختار PAni منجر به دریافت اطلاعات در خصوص میزان مدول ذخیره و مدول اتلاف فیلم شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌تواند با بهینه‌سازی شرایط فرایندی کمک شایانی به ساخت فیلم‌های پلیمری نازک مورد استفاده در ساخت ادوات نانوالکترونیک کند.

۲ بخش تجربی

۲-۱ شرح مواد

آنیلین (۹۹/۵٪)، پودر آمونیوم پراکسی دی‌سولفات، نرمال-متیل-۲-پیرولیدین (NMP)، اسید کلریدریک (۳۷٪)، اتانول (۹۹/۹٪) و آب مقطر در آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. برای انجام آزمایش‌های لایه نشانی از لام شیشه‌ای از جنس کوارتز (به ابعاد $2\text{ mm} \times 20\text{ mm}$) استفاده شد.

۲-۲ سنتز PAni

سنتز شیمیایی PAni از طریق واکنش اکسایش آنیلین با محلول $0/5$ مولار آمونیوم پراکسی دی‌سولفات در دمای K_{323} تحت اتمسفر نیتروژن انجام شد تا رسوب خشک سبز رنگ حاصل به دست آید. پودر حاصل با 100 mL از حلal NMP حل شده و ترکیب به دست آمده به مدت ۲ ساعت در دمای محیط همزده شد تا محلول یکنواختی برای مرحله بعدی حاصل شود.

۲-۳ روش تهیه نمونه‌ها و لایه نشانی

ابتدا فیلم PAni به کمک دستگاه لایه نشانی غوطه‌وری روی سطح لام شیشه‌ای از جنس کوارتز تهیه شد. پس از لایه نشانی، فیلم‌های مرطوب در آون حرارتی در محدوده دمایی 418 K تا 298 K تحت اتمسفر نیتروژن به مدت

۳-۲ تعیین مدول کشسانی فیلم

با داشتن ضریب پوآسون و مدول برشی فیلم، مدول کشسانی فیلم E به دست می‌آید:

$$E = 2G(1+\nu) \quad (5)$$

۳-۳ تعیین سختی سطحی فیلم

سختی سطحی فیلم H از تحلیل کشسانی نتایج بارگذاری فیلم از طریق رابطه زیر به دست می‌آید:

$$H = P_{\max}/A_C \quad (6)$$

در این رابطه P_{\max} بیشینه بار اعمالی حین بارگذاری و A_C سطح مقطع افقی ناحیه تماس سوزن فرورونده با سطح مقطع مشخص است.

۴ نتایج و بحث

۴-۱ تعیین ضخامت و ساختار سطحی فیلم PAni

آزمایش‌های ارتفاع سنجی به کمک ارتفاع سنج MTS نشان دادند که متوسط ضخامت فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکیسته به شرایط عملیات گرمایی از ۳۱۸ K تا ۴۱۸ K به ترتیب از 300 ± 23 nm به 340 ± 40 nm افزایش پیدا خواهد کرد.

شکل ۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (الف و ب) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (ج و د) فیلم را در دماهای ۳۱۸ K (الف و ج) و ۴۱۸ K (ب و د) نشان می‌دهد. همان‌گونه که از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص است سطح فیلم دارای خلل و فرج و حفره بوده و کاملاً صاف نیست و با افزایش دمای خشک کردن میزان یکنواختی سطحی فیلم کاهش یافته و اندازه حفره‌ها بزرگ‌تر می‌شود. بررسی سطحی از نقاط مختلف فیلم نشان می‌دهد متوسط اندازه حفره‌ها در سطح فیلم حرارت داده شده در دمای ۳۱۸ K برابر 25 nm (با توزیع اندازه حفرات بین 15 تا 40 nm) است. در مورد فیلم حرارت داده شده در دمای ۴۱۸ K از دو برابر 44 nm با توزیع اندازه حفرات بین 36 تا

توسط دستگاه AFM تعیین شد. به منظور تعیین درصد حلال موجود در نمونه‌ها از دستگاه تحلیل‌توzین حرارتی مدل TGA، Perkin Elmer، Pyris1 برای اندازه‌گیری وزن نمونه‌ها در خلال گرمایش با نرخ حرارتی 10 K/min توسط گاز خالص نیتروژن استفاده شد. چگالی نمونه‌ها توسط دستگاه چگالی سنج مدل 331C اندازه‌گیری شد.

۳ بخش تئوری

تعیین ضریب اتلاف مکانیکی فیلم

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'} \quad (1)$$

در این رابطه و به ترتیب مدول ذخیره و مدول اتلاف فیلم نانوساختار PAni هستند.

۱-۳ تعیین میزان سختی، ضریب پوآسون و مدول کشسانی

میزان سختی و مدول کشسانی و ضریب پوآسون فیلم پلیمری با استفاده از روش اندازه‌گیری به کمک مبدل‌های موج P- و موج S- از طریق روابط زیر تعیین می‌شوند:

برای تعیین ضریب پوآسون داریم:

$$\nu = \frac{M - 2G}{2M - 2G} = \frac{V_p^2 - 2V_s^2}{2(V_p^2 - V_s^2)} \quad (2)$$

در این رابطه G مدول برشی فیلم بوده و M مدول موج P است که از طریق روابط زیر تعیین می‌شوند:

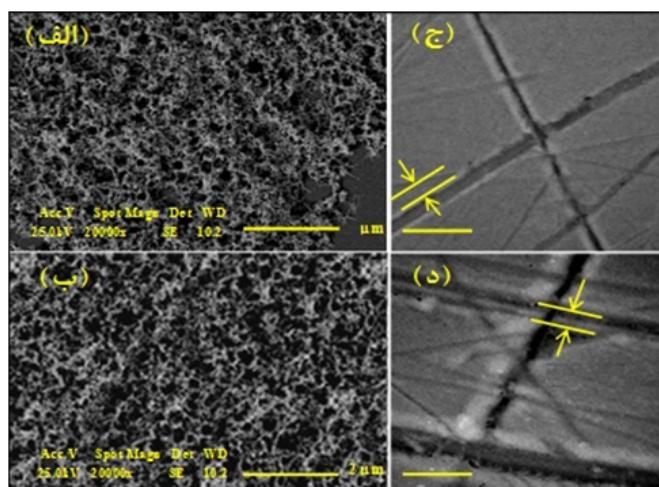
$$M = \rho V_p^2 \quad (3)$$

$$G = \rho V_s^2 \quad (4)$$

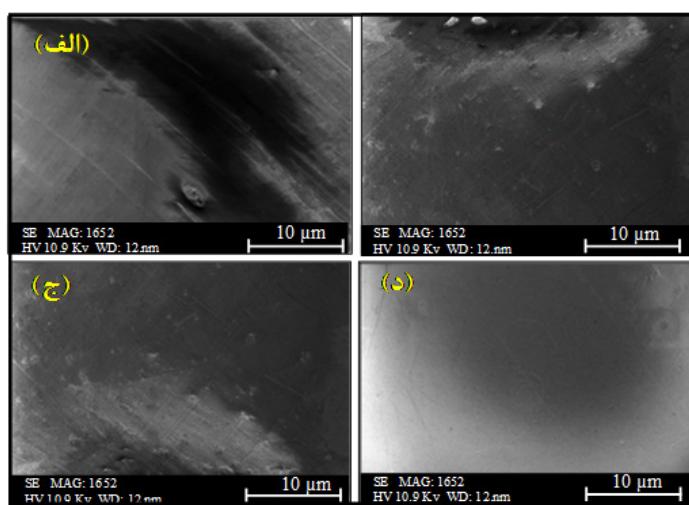
در این روابط ρ چگالی فیلم پلیمری، V_p سرعت پالس موج P و V_s سرعت پالس موج S است. مقادیر V_p و V_s در مراجع برابر 2727 m/s و 1369 m/s گزارش شده است که بر اساس آن میزان تغییرات ضریب پوآسون بین 0.33 تا 0.40 برای مواد پلیمری مختلف متغیر است [۱۷ و ۱۸].

میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص است با اعمال فشار مکانیکی روی سطح فیلم از $0/1 \text{ MPa}$ (شکل ۴الف) به 5 MPa (شکل ۴د) میزان یکنواختی سطحی فیلم افزایش می‌یابد. طبق مطالعات گذشته بالا بودن میزان ناهمگونی سطحی در فیلم‌های تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی می‌تواند تحت تأثیر عواملی همچون شرایط لایه نشانی غوطه وری شامل بالا بودن سرعت کشش و عدم یکنواختی شیمیایی محلول پلیمری و شرایط فیزیکی نظیر تغییر در دمای خشک کردن فیلم و افزایش نرخ تبخیر حلال از درون فیلم مرتبط دانست [۱۲ و ۱۴]. میزان متوسط زبری سطحی فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی 63 nm تعیین شد. با افزایش فشار مکانیکی وارد بر سطح فیلم میزان ۵ MPa یکنواختی افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در فشار سطح فیلم کاملاً یکنواخت بوده و میزان متوسط زبری سطحی فیلم به کمتر از 35 nm می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد اعمال فشار مکانیکی، تأثیر زیادی بر میزان یکنواختی سطحی فیلم PAni می‌گذارد. آزمایش‌های تعیین ارتفاع فیلم به کمک ارتفاع‌سنج نوری نشان دادند میزان ضخامت فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی از $300 \pm 32 \text{ nm}$ به کمتر از $251 \pm 12 \text{ nm}$ در

50 nm افزایش پیدا می‌کند. افزایش اندازه حفره‌ها با افزایش دما را می‌توان به دلیل افزایش سرعت تبخیر حلال NMP از سطح فیلم در دمای بالا ارزیابی کرد که در نهایت منجر به تشکیل حفره و غیریکنواختی سطحی می‌شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان می‌دهند با افزایش دما ساختار سطحی فیلم از حالت لیفی (شکل ۳ب) به صورت شبکه‌ای متقطع (شکل ۳د) در می‌آید. مطابق تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری، قطر لیف‌ها از حدود 18 nm برای فیلم خشک شده در دمای K_{318} به حدود 30 nm برای فیلم حرارت داده شده در دمای K_{418} افزایش پیدا می‌کند. افزایش قطر نanolیف‌های حاصل به دلیل به هم چسبیدن زنجیره پلیمری روی سطح فیلم PAni است. طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری طول زنجیره‌های لیفی پلی آنیلین از چند صد نانومتر تا حدود دو میکرومتر می‌تواند برسد که به شکل کلاف‌های درهم تنیده (خصوصاً در دمای K_{418}) متخلخل درآمده‌اند. شکل ۴ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلم PAni تهیه شده در دمای K_{318} بدون اعمال فشار مکانیکی (الف) و تحت فشارهای $0/5$ (ب)، $1/0$ (ج) و $5/0 \text{ MPa}$ را نشان می‌دهد. همان‌گونه که از تصاویر



شکل ۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (الف و ب) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (ج و د) فیلم پلی آنیلین تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی در دمای 318 K (الف و ج) و 418 K درجه کلوین (ب و د)

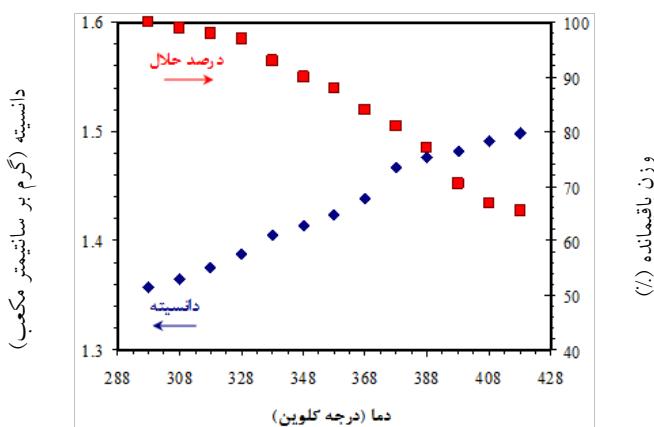


شکل ۴ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلم پلی آنیلین تهیه شده در دمای K ۳۱۸ تحت فشارهای ۰/۱ (الف)، ۰/۵ (ب)، ۵/۰ (ج) و ۱۰/۰ مگاپاسکال

اندازه گیری خواص گرمایی و مکانیکی-دینامیکی فیلم PAni به کمک آزمون دینامیکی-مکانیکی-حرارتی انجام شد تا از نتایج آن بتوان دمای انتقال شیشه‌ای فیلم در دماهای مختلف خشک کردن و فشار اعمال شده روی سطح آن را به دست آورد. شکل ۶ نتایج آزمون دینامیکی-مکانیکی-حرارتی تغییرات لگاریتمی مدول ذخیره (الف) و مدول اتلاف (ب) بر حسب دمای خشک کردن فیلم نانوساختار PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و فشار ۵ MPa نشان داده شده است. آزمایش‌ها در نرخ گرمایی ثابت ۲ K/min تحت فرکانس ۱ Hz انجام گردید. همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقدار مدول ذخیره با افزایش دمای خشک کردن فیلم پلیمری در محدوده دمایی ۲۹۸ تا ۴۱۸ K روندی ثابت و پس از آن تا دمای K ۴۱۸ از مقدار ۵/۵ GPa به ۳/۵ GPa کاهش پیدا می‌کند. در محدوده دمایی مشابه، مقدار مدول اتلاف فیلم PAni افزایش پیدا می‌کند تا به بیشترین مقدار خود در دمای K ۳۷۸ رسیده و مجدداً روند تغییرات نزولی به خود می‌گیرد. در دماهای بالاتر از K ۳۷۸ به دلیل افزایش تبخیر سطحی حلal NMP فیلم حالت نرمی خود را از دست داده و مقدار مدول اتلاف آن به طرز چشمگیری کاهش یابد. کاهش مقدار مدول ذخیره

۴-۲ بررسی خواص گرمایی و مکانیکی-دینامیکی فیلم

از آنچه نمونه‌ها در دماهای مختلف (۲۹۸-۴۱۸ K) حرارت دیده‌اند، به دلیل تبخیر سطحی، میزان خشک شدن نمونه‌ها متفاوت است. لذا درصد حلal موجود در نمونه‌ها به دلیل تبخیر آن و در نتیجه چگالی نمونه‌ها در دماهای مختلف متفاوت است. شکل ۵ نتایج تحلیل توزیع حرارتی نمونه فیلم‌های حرارت‌دهی شده در محدوده دمایی ۲۹۸-۴۱۸ K را بر اساس تغییرات چگالی و درصد وزن باقیمانده نمونه نشان می‌دهد. همانطوری که مشاهده می‌شود با افزایش دمای خشک کردن فیلم درصد وزن باقیمانده نمونه کاهش پیدا می‌کند که نشان‌دهنده آن است که میزان حلal NMP موجود در نمونه کاهش یافته (چگالی NMP برابر 10^3 گرم بر سانتیمتر مکعب) و چگالی فیلم افزایش پیدا می‌کند. با توجه به شکل، کاهش وزن باقیمانده در اثر کاهش درصد حلal و افزایش چگالی فیلم تا دمای K ۳۵۰ کند و پس از آن در دمای حدود K ۳۸۸ روند شتابانی به خود گرفته است که این تغییر ناگهانی می‌تواند بر خواص مکانیکی و گرمایی فیلم تأثیرگذار باشد.



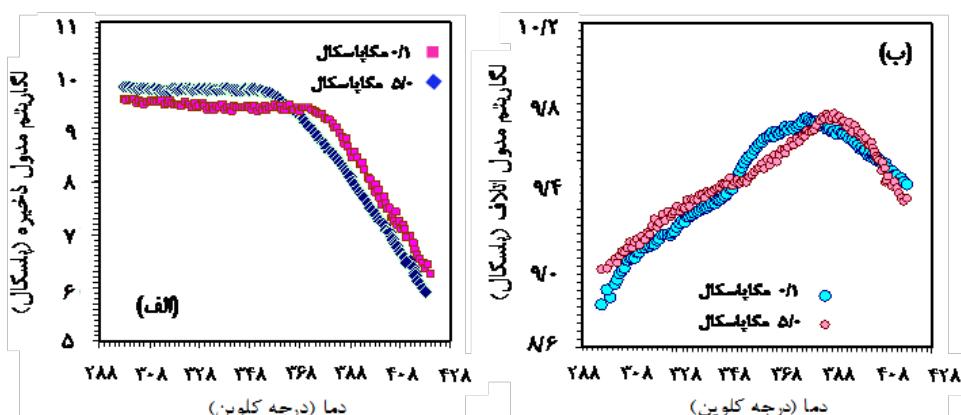
شکل ۵ تغییرات چگالی و درصد وزن باقی‌مانده فیلم پلی آنیلین در محدوده دمایی ۲۹۸-۴۱۸ K

حالت شیشه‌ای به خود بگیرد. آزمایش‌ها نشان دادند دمای شیشه‌ای فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و فیلم تهیه شده تحت فشار ۵ MPa به ترتیب برابر ۳۸۶ و ۳۷۸ K است که با نتایج گزارش شده در مقالات (K ۳۷۸-۴۹۳) همخوانی دارد [۱۵ و ۱۷]. مطابق با نظریه سیتیک کشسانی، مقدار مدول ذخیره فیلم پلیمری در ناحیه شیشه‌ای به مقدار انرژی فعالسازی E_a پلیمر در طول فرایند تجزیه گرمایی وابسته است که بر اساس معادله آرنیوس داریم [۲۰]:

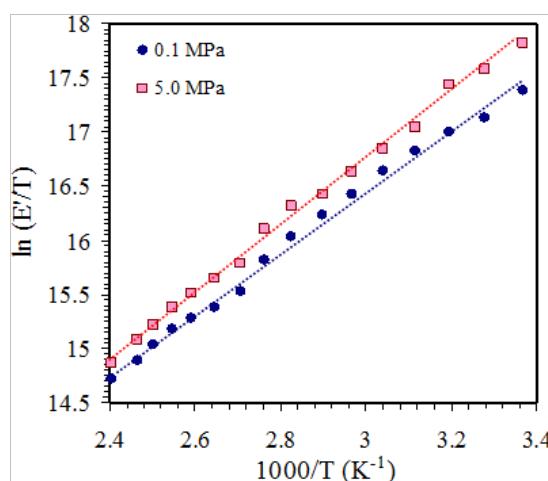
$$E' = A X_c RT \exp(E_a/RT) \quad (6)$$

با افزایش دما، نشان‌دهنده این است که خاصیت پلاستیسیته حلال NMP بسیار قوی تراز برهم کشش‌های بین زنجیره‌های داخلی پلیمر است. در دماهای بیشتر از T_g مقدار مدول ذخیره به طور ناگهانی کاهش پیدا می‌کند که افت مقدار مدول ذخیره در ناحیه انتقال شیشه‌ای روندی طبیعی است.

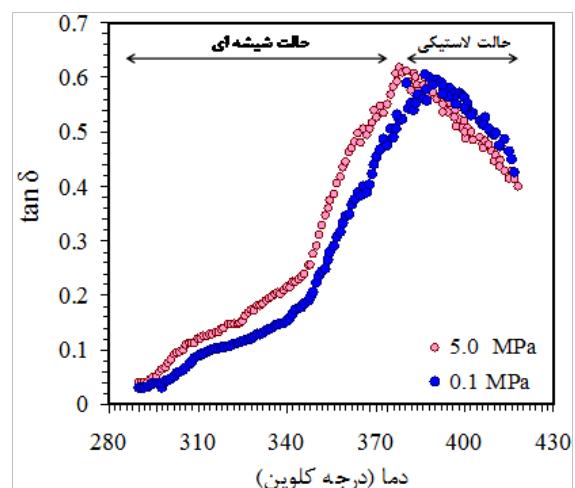
شکل ۷ نتایج تغییرات در دماهای مختلف خشک کردن فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و تحت فشار ۵ MPa نشان می‌دهد. موقعیت بیشینه پیک روی منحنی دما نشانگر مقدار دمای انتقال شیشه‌ای فیلم PAni است. انتظار می‌رود در دماهای بالاتر از دمای انتقال شیشه‌ای فیلم، رفتار لاستیکی و در پایین تر از آن



شکل ۶. تغییرات لگاریتمی مدول ذخیره (الف) و مدول اتلاف (ب) بر حسب دمای خشک کردن برای فیلم نانوساختاری‌بلی آنیلین تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و فشار پنج مگاپاسکال. [آزمایش‌ها در نرخ گرمایی ثابت ۲ K/min تحت فرکانس ۲ Hz اندازه‌گیری شده‌اند].



شکل ۸ منحنی تغییرات لگاریتم طبیعی انرژی فعالسازی بر دما در برابر $T/1000$ فیلم پلی آنیلین بدون اعمال فشار و فشار ۵ مگاپاسکال



شکل ۷ نتایج تغییرات تنازه دلتافیلم‌های نانوساختار پلی آنیلین تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و فشار ۵ مگاپاسکال

نیروی اتمی توسط "حالت خط" به دست آمد. اندازه گیری توسط "حالت خط" این امکان را فراهم می‌سازد تا جهت بررسی بهتر تصاویر، سطح مقطعی معادل $1 \times 1 \text{ mm}^2$ از فیلم پلیمری را بتوان مورد ارزیابی قرار داد. طبق تصاویر، طول فرورفتگی سوزن برکوویچ روی سطح کمتر از یک میکرومتر است و مساحتی در حدود $5 \times 10^4 \text{ nm}^2$ را اشغال می‌کند. افزایش نفوذ سوزن در فیلم نشانده‌نده کاهش مقاومت مکانیکی فیلم پلیمری در برابر ضربه است. همانطور که از شکل ۹ می‌توان دریافت شکل مثلثی حفره‌های ایجاد شده روی سطح، متأثر از شکل هرمی سوزن برکوویچ است که بسته به نوع فشار اعمال شده روی سطح فیلم، ابعاد آن متفاوت خواهد بود.

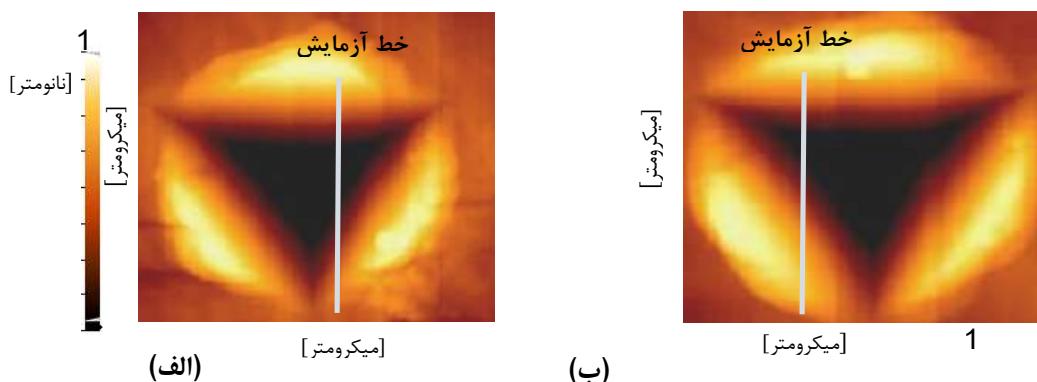
شکل ۱۰ نتایج تغییرات ارتفاع سطحی فیلم PAni تهیه شده (که محل اندازه گیری‌های آن در شکل ۹ با خط نشان داده شده بود) در فشارهای ۱ MPa و ۵ MPa را نشان می‌دهد. همانطور که از شکل مشخص است روند تغییرات ارتفاع در دو شکل، یکسان اما در مورد فیلم تهیه شده در فشار ۵ MPa نسبت به فیلم تهیه شده در فشار ۱ MPa مشاهده می‌شود که میزان فرورفتگی سوزن برکوویچ روی سطح فیلم کمتر بوده و درنتیجه

در این رابطه Xc چگالی پلیمر در دماهای مختلف بر حسب $A \text{ mol/cm}^3$ ، ضریب ثابت R ثابت جهانی گازها و T دمای مطلق بر حسب درجه کلوین است. توجه نمایید که مقادیر چگالی به کار رفته در رابطه اخیر بر اساس داده‌های شکل ۵ برای دماهای مختلف جاگذاری شده‌اند.

در شکل ۸ منحنی تغییرات $\ln E_a/T$ در برابر $T/1000$ فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و فشار ۵ MPa نشان داده شده است. شب این منحنی نشان دهنده E_a پلیمر است. بر اساس روش رگرسیون خطی ($R^2 = 0.97$) مقدار انرژی فعالسازی فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی برابر $22/3 \text{ kJ/mol}$ و در مورد فیلم تهیه شده تحت فشار ۵ MPa برابر $25/1 \text{ kJ/mol}$ تعیین شد که داده‌های به دست آمده در بازه مقادیر گزارش شده در مقالات ($21/7-27/5 \text{ kJ/mol}$) قرار دارند [۲۱].

۴-۴ تأثیر فشار مکانیکی بر تغییرات ارتفاع سطحی فیلم

شکل ۹ نتایج تصویر برداری آزمون دندانه گذاری در مقیاس نانومتری فیلم PAni تهیه شده تحت فشارهای ۱ (الف) و ۵ (ب) از طریق اعمال نیرو در واحد سطح را نشان می‌دهد. تصاویر در دستگاه میکروسکوپ



شکل ۹ تغییرات ارتفاع سطحی فیلم نانوساختار PAAn تحت فشار (الف) ۱ MPa و (ب) ۵ MPa از طریق اعمال نیرو در واحد سطح

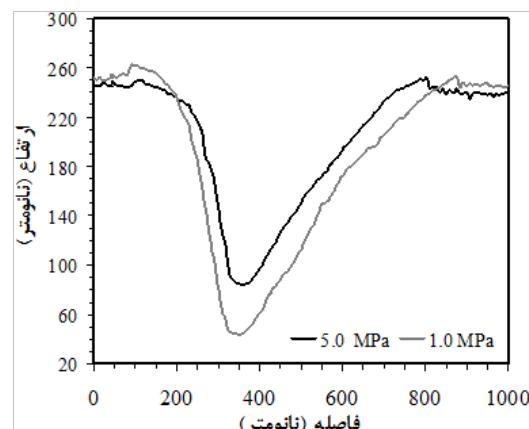
پلیمری تهیه شده در فشار کمتر در برابر خراش است.

۴-۵ تعیین میزان سختی و مدول کشسانی فیلم

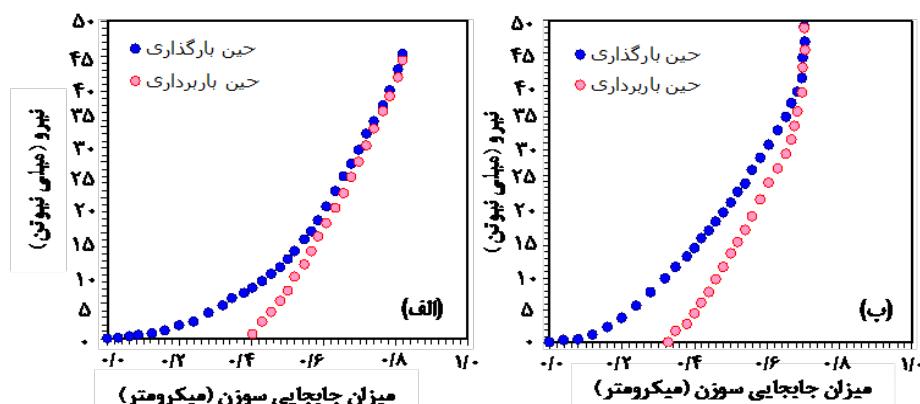
میزان سختی، مدول کشسانی یانگو ضریب پوآسون فیلم نانوساختار PAAn تهیه شده تحت فشارهای مختلف اعمال شده بر سطح فیلم به کمک منحنی تغییرات نیرو بر حسب میزان جابجایی سوزن AFM طبق نظری [Oliver-Pharr22] در جدول ۱ نشان داده شده است. شایان گفتن است که تنها ۲۰ درصد از نتایج مربوط به منحنی بارگذاری برای محاسبه مدول کشسانی مورد استفاده قرار گرفت زیرا در بسیاری موارد تماس نوک سوزن با سطح فیلم منجر به برهم کنش های ناخواسته ای نظیر خراش سطحی می شود که نباید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرند. مطابق جدول ۱ می توان دریافت با افزایش فشار اعمال شده روی سطح فیلم نانوساختار PAAn میزان سختی و مدول کشسانی افزایش پیدا می کند. افزایش میزان مدول کشسانی با فشار اعمال شده روی سطح در مراجع تحت عنوان "اثر انویل" (Anvil effect) شناخته می شود که در تحلیل AFM فیلم های پلیمری به روش دندانه گذاری در مقیاس نانومتری به آن اشاره شده است. طبق آنچه که در مراجع ذکر شده "اثر انویل" بر اثر تغییرات غیربرگشت پذیر پیوندی درون زنجیره پلیمری اتفاق می افتد و موجب می شود چگالی فیلم تهیه شده در فشار بالاتر بیشتر از فیلم تهیه شده در فشار کمتر باشد [۲۳]. همچنین نتایج نشان دادند میزان ضریب پوآسون فیلم نانوساختار PAAn برابر ۰/۳۷ است

استحکام مکانیکی فیلم تهیه شده بالاتر است.

شکل ۱۱ منحنی تغییرات نیروی اعمالی بر سطح فیلم بر حسب میزان جابجایی نوک سوزن AFM را در فشارهای ۱ MPa و ۵ MPa نشان می دهد. از اطلاعات این شکل می توان میزان سختی و مدول کشسانی فیلم PAAn نانوساختار را تعیین کرد. مطابق شکل، میزان نیروی لازم برای ایجاد خراش با عمق ۱۸۰ nm روی سطح فیلم تهیه شده در فشار ۵ MPa با ضخامت ۵ میلیمتر 251 ± 12 nm معادل ۴۹ mN است در حالیکه برای ایجاد همین خراش برای فیلم تهیه شده در فشار ۱ MPa ۴۰ mN نیاز است. این موضوع نشاندهنده کاهش میزان مقاومت فیلم



شکل ۱۰ تغییرات ارتفاع سطحی فیلم نانوساختار PAAn تهیه شده در فشارهای یک و پنج مگاپاسکال (طبق نواحی اندازه گیری در شکل ۹)



شکل ۱۱ منحنی تغییرات نیرو بر حسب فاصله جابجایی سوزن AFM برای فیلم‌های پلی آنیلیستحت فشار (الف) و (ب) ۵ مگاپاسکال

۳۴۰±۴۰ nm افزایش یافت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به دست آمده از فیلم پلیمری حاکی از وجود خلل و فرج و حفره‌های سطحی بود که با افزایش دمای خشک کردن میزان یکنواختی سطحی فیلم کاهش یافته و اندازه حفره‌ها بزرگ‌تر شد. نتایج بررسی سطحی فیلم نشان داد متوسط اندازه حفره‌ها در فیلم حرارت داده شده در دمای K ۳۱۸ برابر ۲۵ nm (با توزیع اندازه حفرات بین ۱۵ تا ۴۰ nm) است. در مورد فیلم حرارت داده شده در دمای K ۴۱۸ به کمتر از دو برابر (۴۴ nm) با توزیع اندازه حفرات بین ۳۶ تا ۵۰ nm افزایش پیدا می‌کند. افزایش اندازه حفره‌های سطحی با افزایش دما را می‌توان به دلیل افزایش سرعت تبخیر حلال NMP از سطح فیلم در دمای بالا ارزیابی کرد که در نهایت منجر به غیریکنواختی سطحی فیلم پلیمری می‌شود.

که این مقدار با مقادیر گزارش شده در مراجع برای پلیمرها مطابقت دارد [۱۸ و ۱۹ و ۲۴].

۵ نتیجه گیری

در این پژوهش خواص دینامیکی-مکانیکی-حرارتی فیلم نانوساختار پلی آنیلین (PAni) لایه‌نشانی شده روی زیرلایه شیشه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سنتز PAni از طریق فرایند پلیمری شدن آنیلین با آمونیوم پرسولفات در محیط اسیدی انجام و پودر حاصل در حلال نرمال متیل-۲-پیرولیدین به شکل محلول درآمد. فیلم‌های نانوساختار PAni به روش لایه‌نشانی غوطه‌وری تهیه و خشک شد. آزمایش‌های ارتفاع سنجی نشان دادند که متوسط ضخامت فیلم پلیمری بسته به میزان گرمادهی از ۳۱۸ تا ۴۱۸ K به ترتیب از ۳۰±۲۳ به

جدول ۱ میزان سختی، مدول کشسانی یانگ و ضریب پوآسون فیلم نانوساختار پلی آنیلین تهیه شده تحت فشارهای مختلف

ضریب پوآسون	مدول یانگ (گیگاپاسکال)	سختی (گیگاپاسکال)	فشار اعمال شده (مگاپاسکال)
۰/۳۷	۳/۰	۰/۲۶	۰/۱
۰/۳۷	۳/۱	۰/۳۰	۰/۵
۰/۳۷	۳/۴	۰/۳۴	۱/۰
۰/۳۸	۳/۶	۰/۳۶	۵/۰

کشسانیو ضربه پوآسون فیلم PAni در فشارهای اعمال شده مختلف مورد استفاده قرار گرفته شد. نتایج نشان دادند میزان ارتفاع فرورفتگی سوزن AFM در مورد فیلم تهیه شده در فشار 5 MPa نسبت به فیلم تهیه شده در فشار 1 MPa کمتر است. درنتیجه استحکام مکانیکی فیلم تهیه شده تحت فشار بالاتر بیشتر است. نتایج این آزمون نشان داد با افزایش فشار اعمال شده روی سطح فیلم نانوساختار PAni میزان سختی و مدول کشسانی یانگ افزایش پیدا می کند. افزایش میزان مدول کشسانی بر اثر تغییرات برگشت ناپذیر پیوندی درون زنجیره پلیمری اتفاق می افتد و موجب می شود چگالی فیلم تهیه شده در فشار بالاتر بیشتر از فیلم تهیه شده در فشار کمتر باشد. نتایج آزمون دینامیکی - مکانیکی - حرارتی فیلم پلیمری برای تعیین دمای انتقال شیشه ای انجام شد. نتایج این آزمون نشان داد دمای انتقال شیشه ای فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و تحت فشار مکانیکی 5 MPa به ترتیب برابر 386 K و 378 K است که با نتایج گزارش شده در مقالات (493 K - 478 K) هم خوانی داشت. بر اساس نظریه سیستیک کشسانی و معادله آرنیوس، مقدار انرژی فعالسازی E_a ، پلیمر در طول فرایند تجزیه گرمایی به مقدار مدول ذخیره فیلم پلیمری در ناحیه لاستیکی به وابسته است. مقدار انرژی فعالسازی فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی برابر kJ/mol $22/3$ و در مورد فیلم تهیه شده تحت فشار 5 MPa برابر $25/1 \text{ kJ/mol}$ تعیین شد که داده های به دست آمده با مقادیر گزارش شده در سایر مقالات هم خوانی دارد. آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی به روش دندانه گذاری در مقیاس نانومتری به منظور تعیین مقادیر سختی، مدول در ساخت تجهیزات نانوالکترونیک کند.

تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان دادند که با افزایش دما ساختار سطحی فیلم از حالت لیفی به حالت شبکه ای متقطع درمی آید. آزمون دینامیکی - مکانیکی - حرارتی فیلم پلیمری برای تعیین دمای انتقال شیشه ای انجام شد. نتایج این آزمون نشان داد دمای انتقال شیشه ای فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی و تحت فشار مکانیکی 5 MPa به ترتیب برابر 386 K و 378 K است که با نتایج گزارش شده در مقالات (493 K - 478 K) هم خوانی داشت. بر اساس نظریه سیستیک کشسانی و معادله آرنیوس، مقدار انرژی فعالسازی E_a ، پلیمر در طول فرایند تجزیه گرمایی به مقدار مدول ذخیره فیلم پلیمری در ناحیه لاستیکی به وابسته است. مقدار انرژی فعالسازی فیلم PAni تهیه شده بدون اعمال فشار مکانیکی برابر kJ/mol $22/3$ و در مورد فیلم تهیه شده تحت فشار 5 MPa برابر $25/1 \text{ kJ/mol}$ تعیین شد که داده های به دست آمده با مقادیر گزارش شده در سایر مقالات هم خوانی دارد. آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی به روش دندانه گذاری در مقیاس نانومتری به منظور تعیین مقادیر سختی، مدول

مراجع

- 1- Belaabed B., Lamouri S., Naar N., Bourson P., Hamady S.O.S. Polyaniline-doped Benzene Sulfonic Acid/epoxy Resin Composites: Structural, Morphological, Thermal and Dielectric Behaviors, *Polym. J.*,42 (1), 546-554, 2010.
- 2- Reena, V.L., Sudha, J.D., Ramakrishnan, R., Development of Electromagnetic Interference Shielding Materials From the Composite of Nanostructured Polyaniline Polyhydroxy Iron clay and Polycarbonate, *J. Appl. Polym. Sci.*, 128 (3), 1756-1763, 2013.
- 3- Bahramian A., Vashaee D., In-situFabricated Transparent Conducting Nanofiber-shape Polyaniline/coral-like TiO₂Thin Film: Application in Bifacial Dye-sensitized Solar Cells, *Sol. Energy Mater Sol. Cells*,143 (1),284-295, 2015.
- 4- Keddie, J. L., Jones, R.A.L., Cory, R.A., Size-Dependent Depression of the Glass Transition Temperature in Polymer Films, *Europhys.Lett.*27 (1), 59-64, 1994.
- 5-TaiQ., ChenB., GuoF., XuSh., HuH., Sebo B., Zhao, X.-Zh., In SituPrepared Transparent Polyaniline Electrode and Its Application in Bifacial Dye-sensitized Solar Cells, *ACS Nano*, 5 (1), 3795-3799, 2011.
- 6- ZhangF., JohanssonM., AnderssonM.R., Hummelen, J.C., InganäsO.,Polymer Photovoltaic Cells With Conducting Polymer Anodes, *Adv. Mater.* 14 (9), 662–665, 2002.
- 7- Yarahmadi E., Didehban Afshord Kh., Shabanian M., Saeb M.R., Assessingthe Crosslinking Behavior of Nanocomposites Based on Epoxy and Starch-modified Graphene Oxide Nanosheets Potent to be Applied as Engineering Coatings, *Appl. Res. Chem. Polym. Eng. (ARCPE)*, 1(1), 61-70, 2017.
- 8- Yan H., Chen Z., Zheng Y., Newman C., Quinn J.R., D'otz F., Kastler M., Facchetti A.,A High-Mobility Electron-Transporting Polymer for Printed Transistors, *Nature*, 457, 679- 687, 2009.
- 9-Isazadeh H., Zahiri A.R., Investigating the Characteristics of Polyaniline and its Composite Films Prepared by Chemical Method, *Iran.J. Polym. Sci. Technol. (Persian)*, 4 (1), 203-209, 2005.
- 10-MacDiarmid A.G., Synthetic Metals: A Novel Role for Organic Polymers (Nobel Lecture). *Angew. Chem. Int. Edit.* 40 (14), 2581-2590, 2001.
- 11- MacDiarmidA.G., Min Y., Wiesinger J., Oh M., Scherr E.J., Epstein A.J., Towards Optimization of Electrical and Mechanical-properties of Polyaniline– is Cross-linking Between Chains the Key. *Synthetic. Met.* 55(2-3),753-760, 1993.
- 12- Huang J., Kaner R.B., A General Chemical Route to Polyaniline Nanofibers. *J. Am. Chem. Soc.* 126 (3), 851-855, 2004.
- 13-Hillman A.R., Mohamoud M.A., Efimov I.,Fundamental Aspects of Electrochemically Controlled Wetting of Nanoscale Composite Materials,*Anal. Chem.*, 83 (14), 5696-5707, 2011.
- 14-BahramianA., Viscoelastic Properties of Polyaniline-emeraldine Base Nanostructured Films: Experimental Results and Molecular Dynamics Simulations, *J. Appl. Polym. Sci.* 41858, 1-13, 2015.
- 15-Deore B.A., Yu I., Aguiar P.M., Recksiedler C., Kroeker S., Freund M.S., Highly Cross-Linked, Self-Doped Polyaniline Exhibiting Unprecedented Hardness. *Chem. Mater.* 17 (15),3803-3805, 2005.
- 16- LeeY.M.,Kim, J.H.,KangJ.S.,HaS.Y.,Annealing Effects of Dilute Polyaniline/NMP Solution. *Macromolecules*, 33 (20), 7431-7439, 2000.

- 17-Fryer D.S., Peters R.D., Kim E.J., Tomaszewski J.E., de Pablo J.J., Nealey P.F., White C.C., Wu W.L., Dependence of the Glass Transition Temperature of Polymer Films on Interfacial Energy and Thickness. *Macromolecules*, 34 (16), 5627-5634, 2001.
- 18-Ferencz R., Sanchez J., Blümich B., Herrmann W., AFM Nanoindentation to Determine Young's Modulus for Different EPDM elastomers. *Polym. Test.*, 31 (2), 425-432, 2012.
- 19-Fischer-Cripps A.C., Critical Review of Analysis and Interpretation of Nanoindentation Test Data. *Surf. Coat. Technol.* 200 (1), 4153-4165, 2006.
- 20-Kremer G.M., Soares A.J., A kinetic Model for Chemical Reactions without Barriers, in Rarefied Gas Dynamics, edited by Akashi Abe, AIP Conference Proceedings 1084, American Institute of Physics, New York, 105-110, 2009.
- 21- Gul, G., Ali Shah A.H., Bilal S., Calculation of Activation Energy of Degradation of Polyaniline-Dodecylbenzene Sulfonic Acid Salts via TGA. *J. Sci. Innov. Res.*, 2 (3), 673-684, 2013.
- 22-Oliver W.C., Pharr G.M., An Improved Technique for Determining Hardness and Elastic Modulus using Load and Displacement Sensing Indentation Experiments. *J. Mater. Res.* 7 (6), 1564-1583, 1992.
- 23-Stejskal J., Gilbert R.G., Polyaniline. Preparation of a Conducting Polymer(IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem. 74 (5), 857-867, 2002.
- 24-Suter, U.W., Eichinger, B.E., Estimating Elastic Constants by Averaging Over Simulated Structures. *Polymer*, 43 (1), 575-582, 2002.